



スイス Synova 社  
CEO

Bernold Richerzhagen

## 独自のレーザーマイクロジェット技術を展開、さらなる事業の拡大を図る

Synova は 2007 年に日本と韓国で複数のマイクロマシニングセンターを開設し、従業員数を 30%以上増加させるなど事業を大幅に拡大した。半導体業界全体の成長は非常に健全で、今年はさまざまな買収と提携の下でこうした成長が見られた。2008 年についても同様の傾向が続くと予想している。今後数年間、当社にとって半導体業界が優先市場であり続けることは明白といえる。最近では太陽電池の市場でも実績があり、結晶 Si 系太陽電池の製造用途を中心に当社技術に対する需要が増加してきている。

現在、当社は DISCO Hi-tech Europe との提携を通じて半導体パッケージング用の革命的システム、ハイブリッド・レーザーソー（HLS）を共同開発している。これは、ディスコのダイヤモンド・ソーブレードと Synova のレーザーマイクロジェット技術という両社の最高のソリューションを組み合わせたもので、いかなる厚さの半導体や先進素材のウェーハも処理可能な新たな製造基準の確立へと向かっている。SEMICON Europa 2007 で紹介したプロトタイプの段階から実際の生産段階に向けて提携

の次の段階を着実に進めている。

2008 年は、LDS（レーザー・ダイシング・システム）や LGS（レーザー・グライディング・システム）をはじめ、完全自動機の製品ファミリーを提供することで半導体市場へのサービス提供を継続していく。また、エンドユーザー側で組み込むためのスタンドアローン型レーザーマイクロジェット（LMJ）モジュールを提供するほか、今年すでに発表したビジネスモデル拡大の一環として、特定のパートナー企業と最新の製造ソリューションを共同開発していきたいと考えている。

当社にとって日本は非常に重要な地域である。我々の技術に対して関心も高く、半導体業界ならびにその他の多くの企業から期待されていると感じる。SEMICON Japan への参加を楽しみにしており、ショーが成功することを期待している。